

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



PAX GLOBAL TECHNOLOGY LIMITED

百富環球科技有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：327)

修訂持續關連交易之年度上限

修訂持續關連交易之年度上限

謹此提述本公司日期為二零一九年十二月三十日及二零二一年九月十日之公告（統稱「該等公告」），內容有關（其中包括）於截至二零二二年十二月三十一日止三個年度的年內本集團與高陽集團根據現有框架協議進行之芯片採購交易。

基於董事會近期進行的審閱，預計截至二零二二年十二月三十一日止年度的現有年度上限將不足以滿足本集團之業務需要。有鑒於此，於二零二二年六月二十四日，本公司及高陽訂立二零二二年補充協議，以（其中包括）修訂現有框架協議項下截至二零二二年十二月三十一日止年度的現有年度上限。

上市規則之涵義

於本公告日期，高陽為控股股東，持有本公司已發行股本約33.75%，故為本公司關連人士。因此，經修訂框架協議項下擬進行之芯片採購交易構成上市規則第十四A章項下本公司之持續關連交易。

由於經修訂框架協議項下有關於年度上限之一項或多項適用百分比率超過0.1%但低於5%，其項下擬進行之持續關連交易須遵守上市規則第十四A章項下申報、公告及年度審閱之規定，惟獲豁免遵守通函及獨立股東批准之規定。

* 僅供識別

A. 背景資料

現有框架協議

謹此提述該等公告，內容有關(其中包括)於截至二零二二年十二月三十一日止三個年度的年期(「年期」)內本集團與高陽集團根據現有框架協議進行之芯片採購交易。截至二零二零年十二月三十一日及二零二一年十二月三十一日止兩個年度以及截至二零二二年十二月三十一日止年度之現有年度上限分別為80百萬港元、120百萬港元及140百萬港元。

過往交易金額

截至二零二零年十二月三十一日、二零二一年十二月三十一日止兩個年度及截至二零二二年五月三十一日止五個月，與高陽集團的芯片採購交易之過往交易金額分別約為76.6百萬港元、118.3百萬港元及122.5百萬港元。

二零二二年補充協議及經修訂框架協議

鑑於本集團的持續業務需要及截至二零二二年十二月三十一日止年度之現有年度上限之約88%利用率(截至二零二二年五月三十一日)，於二零二二年六月二十四日，本公司及高陽訂立二零二二年補充協議，以修訂現有框架協議之若干條款，其中包括截至二零二二年十二月三十一日止年度之現有年度上限。

根據經修訂框架協議，本集團與高陽集團的各成員公司可訂立個別協議，當中載列按下列原則磋商的個別芯片採購交易之條款：

- (a) 芯片採購交易將經公平磋商後按正常或較佳商業條款進行；
- (b) 芯片之價格將參考高陽集團所出售予其客戶之相同或同類型產品之價格及業內同類型產品之當時市價釐定；及
- (c) 芯片採購交易之條款及條件(包括整體考慮價格、訂貨量、償付、裝運及出貨條款)將不遜於本集團不時獲獨立第三方提供之條款及條件。

除上述者外，現有框架協議的其他條款及條件並無變動。經修訂框架協議項下芯片採購交易之其他詳情，包括但不限於定價基準、本集團實施的內部控制措施及保障股東權益的措施，可參閱該等公告。

B. 修訂年度上限

現有年度上限及實際代價

截至二零二零年十二月三十一日及二零二一年十二月三十一日止兩個年度以及截至二零二二年十二月三十一日止年度之現有年度上限以及截至二零二零年十二月三十一日、二零二一年十二月三十一日止兩個年度及截至二零二二年五月三十一日止五個月之實際代價載列如下：

	截至下列日期止年度		截至下列
	二零二零年 十二月三十一日 千港元 (經審核)	二零二一年 十二月三十一日 千港元 (經審核)	日期止年度 二零二二年 十二月三十一日 千港元
現有年度上限	80,000	120,000	140,000
實際代價	76,607	118,332	122,518 (截至 二零二二年 五月三十一日 止五個月) (未經審核)

董事會確認，於本公告日期並無超逾截至二零二二年十二月三十一日止年度之現有年度上限。

經修訂年度上限

根據經修訂框架協議，截至二零二二年十二月三十一日止年度之經修訂年度上限為190百萬港元，較截至二零二二年十二月三十一日止年度之現有年度上限增加約36%。

釐定經修訂年度上限之基準及假設

於釐定截至二零二二年十二月三十一日止年度之經修訂年度上限時，董事會已考慮下列因素：(i)現有框架協議項下之過往代價及於同期本集團電子支付終端相關產品之銷售額；(ii)於年期內電子支付終端相關產品之估計市場需求以及本集團之預期業務發展；(iii)芯片的估計市價；及(iv)本集團採納的產能保證措施。

經修訂年度上限由本公司及高陽經考慮(其中包括)以下基準及假設後按公平磋商而釐定：

(a) 過往交易金額及現有年度上限的利用率

於截至二零二二年五月三十一日止五個月，現有框架協議項下所產生的實際交易金額約為122.5百萬港元，佔截至二零二二年十二月三十一日止年度之現有年度上限約88%。

(b) 市場對本集團電子支付終端產品強勁及持續的需求

新型冠狀病毒疫情對無現金支付的影響乃巨大。無現金及無接觸支付已成為消費者偏好的交易方式，本集團因而繼續錄得銷售增長。尤其於二零二一年，與二零二零年相比，本集團錄得27.3%的強勁銷售增長。自二零二二年年初及直至本公告日期，基於本集團電子支付終端產品的總出貨量及目前的手頭訂單，本集團預期本年度的電子支付終端產品的銷售額將會超逾二零二一年。

就計算經修訂年度上限而言，假設(i)市場對電子支付的需求將持續，以致對本集團電子支付終端產品的需求亦將持續；及(ii)目前的手頭訂單將不會被取消或撤回。在此基礎上，由於芯片乃本集團電子支付終端產品的必要部件，本集團預計芯片採購交易將相應增加，以滿足目前的手頭訂單及未來市場需求。

(c) 對芯片持續高企的需求及價格

儘管芯片供應短缺的情況持續穩步改善，但整體芯片供應依然受限，且芯片市價仍然普遍高企。除芯片短缺情況持續外，全球對芯片的需求飆升、生產成本的普遍上漲以及芯片製造商的高產能利用率均導致若干芯片的價格持續居高不下。就計算經修訂年度上限而言，假設芯片的短缺及高企價格於短期內持續。

(d) 本集團的產能保證措施

本集團的製造規模依賴於充足的芯片供應。儘管由於全球芯片產量增加及因經濟萎縮以致對民用電子商品需求減少，而導致全球芯片短缺持續減緩，但鑒於地方政府推出刺激消費的措施將可能刺激對芯片的需求，本集團仍面臨確保充足的芯片部件供應的挑戰。為減輕芯片短缺可能導致生產停滯及銷售下降的潛在影響，本集團將繼續訂購額外芯片以維持充足的存貨水平。就計算經修訂年度上限而言，假設芯片供應於二零二二年下半年將仍然不穩定。

基於上述考量及假設，董事會預期截至二零二二年十二月三十一日止年度的現有年度上限將很快被超逾。

C. 訂立二零二二年補充協議之理由及裨益

新型冠狀病毒疫情、消費者期望及地方政府推出的措施加速了無現金無接觸支付的採納，導致消費者支付行為發生了顯著變化。根據市場預測，預期有關變化將於疫情後持續，且無現金及無接觸支付將在經濟中佔主導。根據目前電子支付終端產品訂單及生產計劃，本集團對本集團電子支付終端產品中作為關鍵部件的芯片的需求將維持強勁。

儘管芯片短缺情況穩步緩解，但預期有關需求將維持強勁。董事會認為，調高截至二零二二年十二月三十一日止年度之現有年度上限將為本集團提供必要的靈活性，以繼續自高陽集團獲得穩定芯片來源，且將維持充足的存貨水平，以應付任何可能發生的短缺、履行對客戶的承諾及接收更多市場訂單並進一步擴大其電子支付產品的市場份額。

鑒於過往本集團及高陽集團之間的友好業務關係，相互理解對方的業務常規及所需標準及高陽集團供應的芯片規格及質量切合本集團需求，董事會認為，自高陽集團購買芯片符合本集團的商業利益，可大幅減少(i)本集團的運營風險，包括因芯片短缺導致產能受阻及生產成本波動，從而可能對其業務經營造成不利影響的芯片短缺風險；及(ii)本集團尋獲新供應商所需的成本及時間，以及令芯片的額外監督及質量檢查相關行政成本降至最低。

董事(包括獨立非執行董事)認為，經修訂框架協議項下擬進行的芯片採購交易乃於本集團一般業務過程中按公平基準進行，二零二二年補充協議的條款乃按公平基準及一般商業條款磋商釐定，且經修訂框架協議條款(包括經修訂年度上限)屬公平合理，且符合本集團及股東整體利益。

本公司日後將繼續審核及監督經修訂框架協議的交易金額，以確保將及時採取必要措施及適當行動，以遵守上市規則項下適用規定。

訂約各方的資料

有關本集團及本公司的資料

本公司為投資控股公司，本集團主要從事開發及銷售電子支付終端產品、提供維護及安裝及支付解決方案服務。於本公告日期，本公司由控股股東高陽持有約33.75%，因此其為本公司的關連人士。

有關高陽的資料

高陽為一間於百慕達註冊成立之有限公司(其股份於聯交所上市)，連同其附屬公司主要從事提供支付交易處理解決方案、金融科技解決方案及服務、平台運營解決方案及金融解決方案。據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，高陽主要股東的最終實益擁有人為渠萬春先生(直接及間接合共持有高陽約23.25%的股本)及車峰先生(間接持有高陽約12.04%的股本)。

上市規則之涵義

於本公告日期，高陽為控股股東，持有本公司已發行股本約33.75%，故為本公司關連人士。因此，經修訂框架協議項下擬進行之芯片採購交易構成上市規則第十四A章項下本公司之持續關連交易。

由於經修訂框架協議項下有關年度上限之一項或多項適用百分比率超過0.1%但低於5%，其項下擬進行之持續關連交易須遵守上市規則第十四A章項下申報、公告及年度審閱之規定，惟獲豁免遵守通函及獨立股東批准之規定。

現時擔任本公司董事之李文晉先生亦同時為高陽之董事，被視為於經修訂框架協議項下擬進行之持續關連交易中擁有重大權益，因此，彼已按照上市規則第13.44條就批准二零二二年補充協議之董事會決議案放棄表決。

釋義

於本公告內，下列詞彙具有以下涵義：

「二零二二年補充協議」 指 本公司及高陽訂立的日期為二零二二年六月二十四日的補充協議，以修訂現有框架協議之若干條款及採納經修訂年度上限；

「年度上限」 指 代價之年度上限；

「聯繫人」 指 具有上市規則所賦予的涵義；

「董事會」 指 董事會；

「芯片」 指 以下各項的統稱：-

- (i) 非接觸卡讀卡芯片(非接觸卡讀卡芯片)；
- (ii) 加密安全處理器芯片(處理器芯片)；及

(iii) 磁條卡加密解碼芯片(加密解碼芯片)；

「芯片採購交易」	指	根據現有框架協議或經修訂框架協議(視情況而定)採購芯片；
「本公司」	指	百富環球科技有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：327)；
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「代價」	指	芯片採購交易的合約總值；
「董事」	指	本公司董事；
「電子支付終端」	指	電子支付銷售點終端；
「現有年度上限」	指	現有框架協議項下代價的年度上限；
「現有框架協議」	指	日期為二零一九年十二月三十日的框架協議(經日期為二零二一年九月十日的補充協議修訂)；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「高陽」	指	高陽科技(中國)有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：818)；
「高陽集團」	指	(於現有框架協議項下)高陽及其附屬公司，以及(於經修訂框架協議項下及僅就本公告而言)高陽、其附屬公司及指定聯繫人；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「香港」	指	中國香港特別行政區；

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國；
「經修訂年度上限」	指	經修訂框架協議項下截至二零二二年十二月三十一日止年度代價的年度上限；
「經修訂框架協議」	指	經二零二二年補充協議修訂的現有框架協議；
「股東」	指	本公司股東；
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「%」	指	百分比。

承董事會命
百富環球科技有限公司
公司秘書
張仕揚

香港，二零二二年六月二十四日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，分別為聶國明先生、蘆杰先生及李文晉先生；以及三名獨立非執行董事葉偉明先生、吳敏博士及文國權先生。